
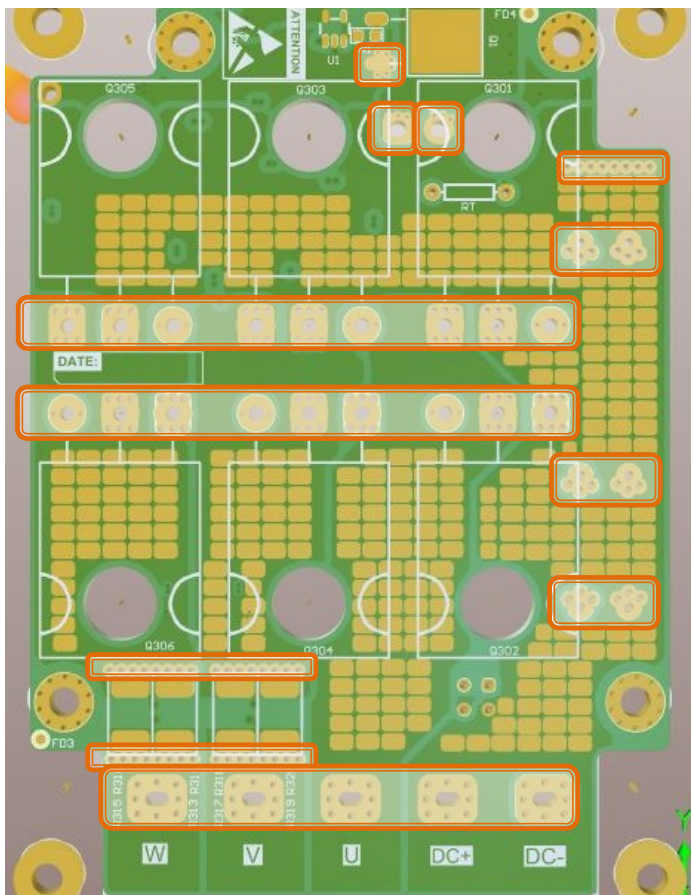


PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	COBRA4820_POW_V9	焊接	QM03322061401	V9	1/2	20230614

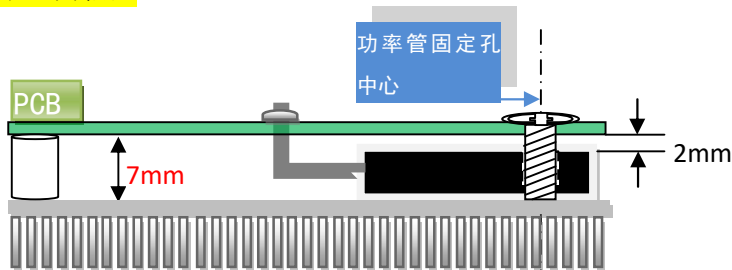
1. COBRA4820_POW_V9 底层加锡位置

 橙色双线框内半透明覆盖的 PAD 区，要求每个焊盘孔内上下焊锡通透（灌满焊锡）

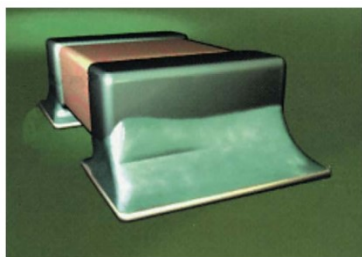


2. 功率管 Q301~ Q306 共计 6 个（TO-247 封装的管子），管脚直角折弯

- a) 高度：功率管的下表面（金属部分）距离 PCB 下表面 7mm 焊接；且要求功率管脚顶层和底层双面焊接；
- b) 焊接后，功率管固定孔中心与 PCB 开孔中心同轴；

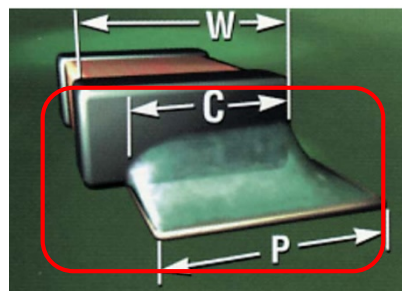


3. 电阻 R314, R316, R318, R320 (4 个) 焊接完成后，保证元件不偏移，见下图（元件的电极与相应焊盘位置重叠）



目标 - 1, 2, 3 级

- 末端连接宽度等于元器件端子宽度或焊盘宽度，取两者中的较小者。

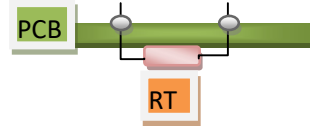


- 可接受:**
- a) 端子 (A) 的侧面偏移不大于端子宽度的 5% (约 0.15mm, 下图为焊接不良图片)。
 - b) 端子连接宽度在与焊盘接触区域有 100% 润湿

备注：该位置要求 100% 目检，不符合要求的，拒收！

PCB 焊接	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
工艺要求	直流伺服	COBRA4820_POW_V9	焊接	QM03323061401	V9	2/2	20230614

4. 温感热敏电阻 RT 紧贴 PCB 的下表面焊接（见右图）：



5. 其他常规焊接要求：

- 1) 所有端口插座焊接需要压到底焊接，不接受歪扭，偏差要小于 0.3mm；
- 2) 所有极性元件，严禁方向反；
- 3) 不接受虚焊，空焊，焊锡短路；
- 4) 未特殊说明的元件，均紧贴线路板焊接；
- 5) 手工操作要做防静电处理；
- 6) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准；
- 7) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	